

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2026-031

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯源微”）于2026年8月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，公司决定对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期。

本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。上述议案无需提交股东会审议，现将募投项目延期的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意沈阳芯源微电子设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]498号），公司于2022年6月向特定对象发行人民币普通股股票8,045,699股，每股面值1元，发行价格为人民币124.29元/股，募集资金总额为人民币999,999,928.71元，扣除不含税的发行费用人民币9,915,093.67元，实际募集资金净额为人民币990,084,835.04元。以上募集资金已于2022年6月8日到位，募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2022]110Z0008号《验资报告》。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储相关的监管协议。具体情况详见公司于2022年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于签署募集资金专

户存储三方监管协议的公告》，及于 2022 年 7 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额	实施主体
1	上海临港研发及产业化项目	64,000.00	47,000.00	上海芯源微企业发展有限公司
2	高端晶圆处理设备产业化项目（二期）	28,939.27	23,000.00	芯源微
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	芯源微
合计		122,939.27	100,000.00	-

三、本次募投项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
1	高端晶圆处理设备产业化项目（二期）	2026 年 12 月 8 日	2027 年 12 月 8 日

（二）本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司严格按照募集资金管理要求，有序推进募投项目各项建设工作。当前“高端晶圆处理设备产业化项目（二期）”主体厂房已完成封顶，建筑外围正在施工。基于对项目当前实际建设进度的审慎评估，为保障项目顺利实施，公司拟将“高端晶圆处理设备产业化项目（二期）”达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 12 月 8 日。

四、重新论证募投项目

募投项目“高端晶圆处理设备产业化项目（二期）”募集资金计划投资额为 2.3 亿元，截至 2026 年 6 月 30 日，实际投入该项目的募集资金金额为 5,509.68 万元，占计划投资额的比例为 23.96%，该项目募集资金专用账户余额为 19,269.59 万元。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定：“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%”，上市公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“高端晶圆处理设备产业化项目（二期）”进行了重新论证：

1、项目建设的必要性

（1）拓展公司前后道涂胶显影设备业务

公司长期专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，紧密跟踪国际先进技术的发展趋势，积极向精细化前沿技术领域发展，积极推动前后道涂胶显影设备的工艺验证及商业化推广。公司重视自身产品技术和性能的不断升级，在主要产品打入前道芯片制造领域的同时，不断推出更高工艺等级的产品。

（2）提升产品生产研发能力，满足业务增长需求

公司已在涂胶显影设备和单片式湿法设备领域深耕多年，凭借持续的技术创新、高性价比的产品及优质的售后服务，已建立一定的行业知名度，下游客户覆盖集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等领域。

随着公司规模及业务的扩张，公司在现有厂区进行半导体设备生产与研发出现一定瓶颈。为更好地完善公司的产品布局，满足未来业务规模扩张需求，进一步提升公司综合竞争实力，公司拟使用本次募集资金建设高端晶圆处理设备产业化项目（二期），提升现有量产半导体设备的供货能力，满足下游客户多元化的定制需求。

2、项目可行性分析

（1）公司拥有丰富的行业经验

公司自成立以来一直专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，深耕光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备，积累了丰富的行业经验。公司是国家集成电路产业技术创新联盟及集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事单位，先后主持制定了喷胶机、涂胶机两项行业标准，奠定了在细分行业内的突出地位。经

经过多年的沉淀，公司与国内外供应商建立了较为稳定的合作关系，培育与建设成了较为完善的原材料供应链，有利于保证公司产品原料来源的稳定性及可靠性。凭借丰富的行业经验，公司具备实施本次募投项目的能力。

（2）公司具有良好的技术储备

公司所处的半导体设备行业属于典型的技术密集型行业，涉及电子、机械、化工、材料、信息等多学科领域，是多门类跨学科知识的综合应用，具有较高的技术门槛，通常是一代器件、一代设备、一代工艺。公司高度重视新技术、新产品和新工艺的研发工作，通过多年的技术积累以及承担国家 02 重大专项，公司已经成功掌握包括光刻工艺胶膜均匀涂敷技术、不规则晶圆表面喷涂技术、精细化显影技术、内部微环境精确控制技术、晶圆正反面颗粒清洗技术、化学药品精确供给及回收技术等在内的多种半导体设备产品核心技术，并拥有多项自主知识产权。

公司建有较为完善的人才培养体系，通过承担国家重大专项及地方重大科研任务、开展专题技术培训等方式培养了半导体设备的设计制造、工艺制程、软件开发与应用等多种学科人才。公司重视技术人才队伍的建设，积极引进了一批具有丰富的半导体设备行业经验的高端人才，形成了稳定的核心技术人才团队，能紧密跟踪国际先进技术发展趋势，具备较强的持续创新能力。公司技术实力雄厚，核心技术人才团队稳定，能够为本次募投项目的实施提供有力保障。

（3）公司具备良好的客户资源保障

经过多年的积累，公司在光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备领域已具备一定的客户优势。公司以沈阳为销售总部，销售网络覆盖长三角、珠三角、中国台湾地区等产业重点区域，建立了快速响应的销售和技术服务团队，已形成了较强的客户资源优势，为本次募投项目的实施奠定了坚实的基础。

3、预计收益分析

公司“高端晶圆处理设备产业化项目（二期）”项目建成并达产后，主要用于前后道涂胶显影机的产业化。项目顺利实施有助于进一步增强公司科技创新水平和持续盈利能力，能够产生良好的经济效益和社会效益。

4、募集资金投资项目重新论证的结论

公司认为，本次募投项目符合公司整体发展战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续推进该募投项目的实施。同时，公司也将密切关注外部政策环境及行业发展变化，对募集资金投资进度进行合理把控。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据自身经营需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

六、履行的审议程序及专项意见

（一）审议程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意对募投项目“高端晶圆处理设备产业化项目（二期）”进行延期。本事项无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：“公司本次募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资规模及实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司本次募投项目延期事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。”

七、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日